

技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所用有關本集團及其業務的若干詞彙釋義。該等詞彙及其釋義未必與行業標準定義或用法完全一致，亦未必可與本公司所在行業的其他公司採用的類似詞彙直接比較。

「2.5D/3D 封裝」	指	通過中介層(2.5D)互連或多晶片垂直堆疊(3D)實現多晶片集成的先進半導體封裝技術，用於在提升性能的同時縮小封裝尺寸
「3D NAND」	指	三維 NAND 閃存，是一種閃存技術，通過將存儲單元垂直多層堆疊，在相同面積內實現更大的存儲容量、更高的速度以及更低的單位比特成本，相比傳統的二維 NAND 具有更高的性能與效率
「研磨粒子」	指	通過機械作用從表面去除、研磨、拋光或平坦化材料的硬質顆粒
「先進封裝」	指	一套創新的半導體封裝工藝技術，將多個芯片和組件集成到單一的高性能單元中，克服傳統封裝的局限性，實現更優的性能、更低的功耗和更小的尺寸
「AI」	指	人工智能，計算機科學的一個領域，專注於通過機器模擬、延伸和擴展人類智能
「ArFi」	指	氟化氫浸沒式光刻，是一種光刻技術，通過在投影透鏡與晶圓之間設置液體浸沒系統，並使用氟化氫(ArF)准分子激光作為光源，從而實現更短的有效波長和更高的分辨率，用於在晶圓上刻畫更微小的半導體結構特徵
「ArF 光刻膠」	指	氟化氫光刻膠，一種用於氟化氫(193 納米)光刻的光刻膠材料，採用含氟聚合物和光致產酸劑，具備高分辨率、高透光率和優異抗刻蝕性能，應用於先進半導體製造
「BARC」	指	底部抗反射塗層，一種在光刻過程中塗覆於光刻膠下方的薄膜，用於降低晶圓表面的光反射，以提高圖形精度和關鍵尺寸控制
「粘結劑」	指	用於將活性顆粒粘合在一起並使其附著於鋰電池電極集流體上的材料
「複合年增長率」	指	複合年增長率

技術詞彙表

「CMP」	指	化學機械拋光，一種結合化學腐蝕和機械磨削的拋光方法，用於精密加工領域
「清洗液」	指	CMP後清洗液，一種化學機械拋光後，針對晶圓表面顆粒、有機殘留物有清除作用的配方清洗溶液
「CMP拋光墊」	指	化學機械拋光墊，是化學機械拋光中的核心耗材之一，主要作用是承載和輸送拋光液、排出磨屑和維持穩定的拋光環境等
「CMP拋光液」	指	化學機械拋光液，是一種用於化學機械拋光工藝的液態材料，含有磨料顆粒和化學反應組分，與拋光墊配合使用，通過化學與機械雙重作用實現半導體製造過程中晶圓表面的平坦化
「塗佈型材料」	指	通過塗佈工藝以薄層形式施加於基材表面，以形成功能性薄膜或塗層的材料
「CPT」	指	彩色聚合碳粉，一種通過聚合工藝生產的彩色碳粉，具有均勻的粒徑、高圖像質量和優異的打印性能
「緩衝墊」	指	在製造或拋光過程中用於提供緩衝、支撐或壓力分佈的墊層
「分散劑」	指	用於在電池漿料中均勻分散固體顆粒並提高其穩定性和加工性能的添加劑
「顯示面板」	指	電子顯示設備中用於生成圖像的核心屏幕部件
「DRAM」	指	動態隨機存取存儲器，一種用於計算機和其他設備的易失性存儲器，用於存儲正在使用或處理的數據，需要定期刷新以維持所存儲的信息
「發泡」	指	在材料中形成氣泡，從而產生多孔或泡孔結構的過程
「晶圓代工廠」	指	為其他公司設計的芯片提供製造服務的半導體製造企業
「IDM」	指	集成器件製造商

技術詞彙表

「墨盒」	指	裝有液體墨水、用於噴墨打印機生成打印文字和圖像的可更換耗材組件
「集成電路」	指	一種將晶體管、電阻、電容等多個電子元件集成在同一塊半導體芯片上，以實現特定功能或運算處理的電子器件
「KrF光刻膠」	指	氟化氬光刻膠，一種用於氟化氬(248 納米)光刻的光刻膠材料，具有高透光率和高分辨率，適用於深紫外波段的半導體圖形製程
「LCD」	指	液晶顯示器，一種利用液晶調製光線並產生圖像的平板顯示技術
「鋰電池」	指	一種以鋰或鋰化合物作為關鍵活性材料來儲存和釋放電能的電池
「鋰電池功能性輔材」或「功能性輔材」	指	用於提升鋰電池加工性能、穩定性和整體功能的輔助材料
「微球」	指	通常處於微米尺度的微小球形顆粒，用於賦予材料或產品特定的物理、化學或功能性能
「單體」	指	能夠與其他相同或類似分子發生化學鍵合並形成聚合物的小分子
「NMP」	指	1-甲基-2-吡咯烷酮，一種常用於化學配方和聚合物加工的極性非質子溶劑
「OLED」	指	有機發光二極管，一種顯示與照明技術，通過有機化合物在通電時發光，實現自發光、高對比度、超薄及可彎曲顯示等特性
「封裝」	指	半導體芯片進行包封和保護，並在芯片與外部系統之間提供電氣連接的過程
「封裝PI」	指	用於半導體封裝中的高性能聚合物絕緣材料，主要用於應力緩衝、鈍化、再佈線層絕緣及器件保護
「光致產酸劑」	指	在光照下產生酸的化合物，用於在光敏材料中引發光誘導化學反應

技術詞彙表

「PET」	指	聚對苯二甲酸乙二醇酯，一種常見的聚酯塑料，用於薄膜、瓶子和紡織纖維
「PFAS-free」	指	不含全氟和多氟烷基物質(PFAS)，某種材料或產品不含PFAS，而PFAS這類人工合成化學物質以難降解和潛在健康風險而著稱
「PI」	指	聚醯亞胺，一種廣泛應用於航天航空、柔性電子以及半導體封裝的關鍵材料，具有鈍化、絕緣、應力緩衝、隔熱、圖案化等功能
「高分子」	指	由許多重複分子單元組成的大分子，用於形成塑料、樹脂、纖維、薄膜等材料
「預聚體」	指	帶有反應性基團、可進一步聚合或固化形成最終聚合物材料的中間聚合物
「PSPI」	指	光敏聚醯亞胺，一種可通過光刻工藝進行圖形化的聚醯亞胺材料，因其具有優異的耐熱性和工藝適應性，廣泛應用於OLED和半導體製造中的平坦化層、像素定義層及絕緣層
「RDL」	指	重佈線層，一種先進封裝中使用的金屬佈線層，用於將芯片連接焊盤重新佈局到不同位置，以便於外部連接
「樹脂」	指	用作塗料、膠粘劑、塑料及其他材料中的粘結劑、基體或成膜組分的天然或合成聚合物材料
「SiN」	指	氮化硅，一種常用於半導體製造中的介電材料，用於絕緣、鈍化和掩模
「SOC」	指	旋塗碳，一種用於光刻工藝的碳基旋塗材料，作為硬掩模或底部抗反射層使用，具有優異的抗刻蝕性、平坦化性能和光吸收能力，適用於先進半導體圖形製程
「合成」	指	通過化學方式將較簡單的物質結合生成較複雜化合物或材料的過程

技術詞彙表

「TBA」	指	臨時鍵合膠，一種用於半導體工藝中晶圓臨時鍵合的粘合材料，在後續製程步驟中提供機械支撐和保護，隨後進行解鍵合。
「TEOS」	指	正硅酸乙酯，一種含硅化學品，常用作半導體製造中沉積氧化硅薄膜的前驅體
「TFE-INK」	指	薄膜封裝油墨，一種用於OLED及其他顯示器製造的功能性材料，用於薄膜封裝，以提供防潮、防氧保護，提升器件的可靠性與壽命
「TiN」	指	氮化鈦，一種硬質導電塗層材料，常用於半導體製造中作為阻擋層、粘附層或金屬柵極材料
「硒鼓」	指	裝有碳粉、用於激光打印機或複印機形成打印文字和圖像的可更換耗材組件
「硅通孔」	指	硅通孔，指貫穿硅晶圓或芯片的垂直電互連結構，用於實現高密度三維芯片集成
「VR/AR」	指	虛擬現實和增強現實，兩類沉浸式人機互動技術，其相關設備通常配備需應用先進OLED技術的高端OLED顯示屏
「晶圓」	指	通常由硅等半導體材料製成的薄片，用作製造集成電路或其他微電子器件的基底
「YPI」	指	黃色聚醯亞胺，一種具有黃色高透光性的聚醯亞胺材料，具備優異的高溫耐熱性、化學穩定性與良好的機械性能，可於前端OLED面板製造過程中形成聚醯亞胺 YPI 薄膜，取代剛性熒幕中使用的玻璃基板材料